

<<系统芯片>>

图书基本信息

书名：<<系统芯片>>

13位ISBN编号：9787121005893

10位ISBN编号：7121005891

出版时间：2005-1-1

出版时间：电子工业出版社

作者：孙海平, Peter Paterson, 丁健, Prakash Rashinkar, Leena Singh

页数：263

字数：448000

译者：孙海平, 丁健

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<系统芯片>>

内容概要

本书从最高层次的系统级验证直至最终的物理实现和签付，详细介绍了各种设计抽象级别和各阶段所涉及到的各种验证方法及工具。

主要内容包括各种不同类型的仿真、软件/硬件协同验证、数字/模拟混合验证、网表静态验证、物理验证、测试平台迁移、形式模型与等价性检查、代码静态检查与代码覆盖状况分析、定向随机测试等验证技术。

本书以蓝牙系统芯片为例，各章中有结合实际的代码和脚本可供读者参考，以帮助读者进一步深入理解。

本书内容全面、翔实，可作为从事系统芯片设计的工程人员、研究者和高等院校相关专业师生的参考材料，对于从事传统集成电路设计和验证的人员有较高的指导和借鉴价值。

<<系统芯片>>

作者简介

Prakash Rashinkar在通信卫星、运载火箭、太空船地面系统、高性能计算机、网各交换、多媒体和无线应用等领域拥有超过15年的嵌入式系统设计和验证工作经验。

他毕业于印度Warangal的Regional Engineering College，获电气工程理学硕士学位。

他在Cadence Design Systems公司领导

<<系统芯片>>

书籍目录

第1章 绪言 1.1 工艺的挑战 1.2 可供选用的验证技术 1.3 验证方法 1.4 测试平台的建立 1.5 测试平台的迁移 1.6 验证语言 1.7 验证IP重用 1.8 验证途径 1.9 验证和器件测试 1.10 验证计划 1.11 蓝牙系统芯片的参考设计 参考文献第2章 系统级验证 2.1 系统设计 2.2 系统验证 2.3 蓝牙系统芯片 参考文献第3章 功能级验证 3.1 IP功能块 3.2 功能块级验证 3.3 蓝牙系统芯片的功能块细节 3.4 代码静态检查 3.5 模型形式检查 3.6 功能验证与仿真 3.7 协议检查 3.8 定向随机测试 3.9 代码覆盖状况分析 参考文献第4章 模拟与混合信号仿真 4.1 混合信号仿真 4.2 设计抽象层次 4.3 仿真环境 4.4 使用SPICE 4.5 仿真方法 4.6 蓝牙系统芯片中的数模转换器 4.7 含模拟混合信号功能块的芯片级验证 参考文献第5章 仿真 5.1 功能仿真 5.2 测试平台壳 5.3 基于事件的仿真 5.4 基于周期的仿真 5.5 ASB/APB桥的仿真 5.6 基于事件和基于周期相混合的仿真 5.7 基于事务的验证 5.8 仿真加速 参考文献第6章 软件/硬件协同验证 6.1 软件/硬件协同验证环境 6.2 仿效 6.3 软原型或虚拟原型 6.4 协同验证 6.5 快速原型系统 6.6 软件/硬件验证方法的比较 6.7 基于FPGA的设计 6.8 开发电路印刷板 6.9 软件测试 参考文献第7章 网表静态验证 7.1 网表验证 7.2 蓝牙系统芯片的仲裁器 7.3 等价性检查 7.4 时序静态验证 参考文献第8章 物理验证与设计签付 8.1 设计检查 8.2 物理效应分析 8.3 设计签付参考文献附录 术语表

<<系统芯片>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>